

NEXTY ELECTRONICS WORLD

vol.167 APR 2017

特集企画：NEXTY Electronics

2017年4月、株式会社ネクスティ エレクトロニクスが誕生しました

特集企画：オスラム オプトセミコンダクターズ

オスラム特集 “Light is OSRAM”

オートモーティブ ～次世代を照らす先駆者～

コンシューマー ～先端技術への応用～

一般照明 ～より美しく照らすために～



はじめまして、
ネクスティ エレクトロニクスです。

次の、未来へ。

Be the Next Bridge to the Future

「株式会社トーメンエレクトロニクス」と「株式会社豊通エレクトロニクス」が
合併し、新生 株式会社ネクスティ エレクトロニクスが誕生しました。
次の時代の技術 (Next Technology) を常に追い掛けると共に、
世界に発信し続ける企業を目指します。

CONTENTS

特集企画：NEXTY Electronics

- 株式会社ネクスティ エレクトロニクス 2017年4月、株式会社ネクスティ エレクトロニクスが誕生しました 3

特集企画：オスラム オプトセミコンダクターズ

- オスラム オプトセミコンダクターズ オスラム特集 “Light is OSRAM” 5
- オスラム オプトセミコンダクターズ オートモーティブ ～次世代を照らす先駆者～ 7
- オスラム オプトセミコンダクターズ コンシューマー ～先端技術への応用～ 9
- オスラム オプトセミコンダクターズ 一般照明 ～より美しく照らすために～ 10

汎用

- Texas Instruments社 シネマからオートへDLP®テクノロジー 11
- Texas Instruments社 カメラ向けFPD-LINKⅢ 12
- Micron Technology社 Micron社製 SSDラインナップのご案内 13

モジュール

- u-blox AG社 u-blox社のLPWAソリューション 14
- Vishay Intertechnology社 極薄/超低背0.8mm IRレシーバーモジュール [TSOP57x] シリーズ 15

その他注目製品

- Infineon Technologies社 システムコストダウンをご提案 インフィニオン社製Smart IPM [iMOTION] 待望のリリース 16
- Maxim Integrated社 SDR用ラジオチューナー 17
- Texas Instruments社 車載向けDCDCコンバーター 18

ディスクリート

- STマイクロエレクトロニクス社 SiCパワーMOSFET/AEC-Q101車載対応SiCダイオード 19

その他

- Sierra Wireless社 W/W対応Sierra Wireless社のSIM製品 20

- 取扱い製品一覧 21

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

2017年4月、株式会社ネクスティ エレクトロニクスが誕生しました



次の、未来へ。

株式会社トーマンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年4月1日に合併し、「株式会社ネクスティ エレクトロニクス」となりました。各社が持つ「技術、品質、機能」の強みを一層強化し、グローバルネットワークを活かした、世界で活躍するエレクトロニクス商社を目指します。



代表取締役社長 青木 厚

ごあいさつ

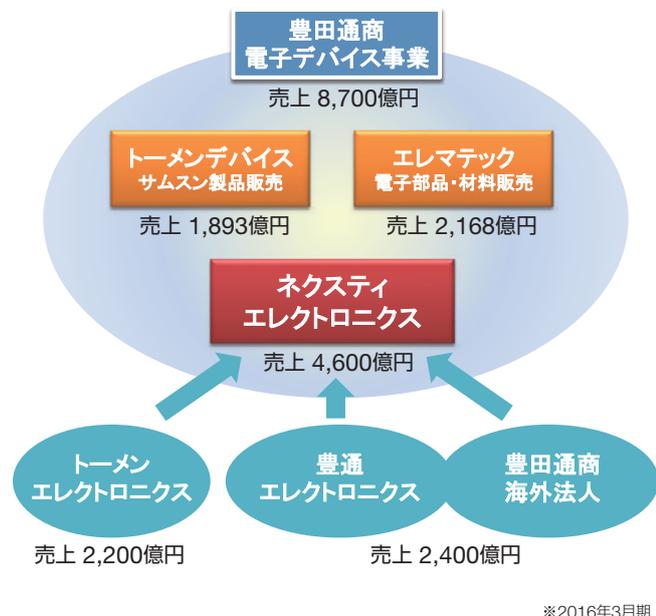
2017年4月、「ネクスティ エレクトロニクス」が誕生しました。技術革新、業界変革の中、自動運転に向けたカーエレクトロニクスの進化をドライブするとともに、技術商材を核としてIoT・産業機器等、幅広い分野でお客様や世の中のニーズに応え、社会の課題を解決するソリューションを提供していきます。

社名に込めた想いを社員一人ひとりが心に秘め、上下一心(しょうかいっしん)、上司も部下もなく心を一つにして新しい会社を創って参ります。

また豊田通商グループにおけるエレクトロニクス事業の中核企業として、グループの総合力を活かし、エレクトロニクス産業を牽引していく会社になる様、社員一同頑張ります。今後ともご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

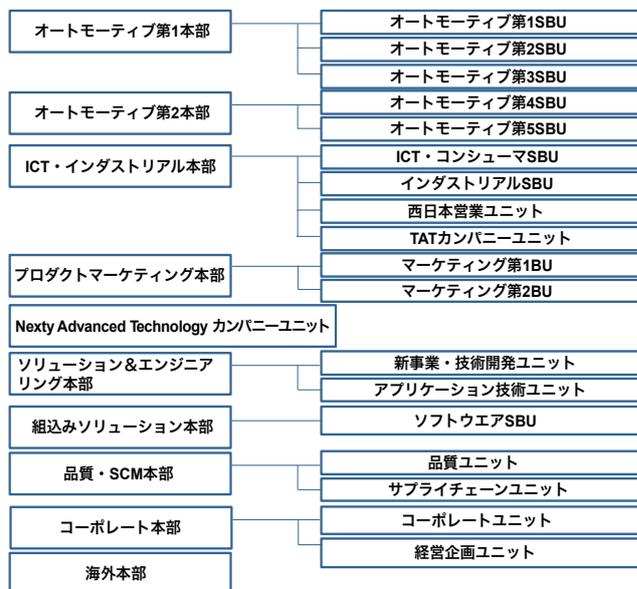
豊田通商グループの中のネクスティ エレクトロニクス

豊田通商グループにおけるエレクトロニクス中核企業としてグループの総合力を活かし、エレクトロニクス産業を牽引していきます。



新組織

お客様に密着し、お客様の産業特性とアプリケーションを理解し、お客様により良い提案をする「ユーザーオリエンテッド」なエレクトロニクス商社を目指します。



シンボルマークに込めた想い

チャレンジスピリットと先進性を印象づけるデザインに

全体的なフォルムは、トーマンエレクトロニクス(Tomen Electronics)と豊通エレクトロニクス(Toyota Tsusho Electronics)それぞれの「T」を象徴しています。カラーリングは、2つの企業が力を合わせて次のステージへ挑戦する躍動感を赤のグラデーションで表現。また、NEXTYの頭文字Nを、先進性を感じさせるシルバーで表現しています。

～国内最大規模、車載分野では世界最大のエレクトロニクス商社へ～

ネクスティの強み

車載分野で培った「技術」「品質」「機能」に基づく提案力

車載をコアに次の柱となる事業を構築します。(ICT・インダストリアル分野等)



サプライチェーンをフルカバーする機能を持つ

品質サポート

[VAセンター]



TEL : 042-846-0088
FAX : 042-846-0099

- [機能]**
- メモリーのデータ書き込み
 - テーピング梱包作業
 - 外観/機能選別検査
 - 不具合解析

[TAQSセンター]



TEL : 056-696-4433
FAX : 056-697-3467

- [機能]**
- 不具合解析
 - 信頼性評価
 - 外観/機能選別検査
 - テーピング梱包作業

[外観目視検査業務]



顕微鏡を使用した外観検査



自動外観検査装置

[機能検査業務]



HDD不良解析



通信モジュール検査



液晶パネル点灯検査

検査、スクリーニングから初期不具合解析、故障解析・原因解析などの品質サポートを行っています。そのキャリアとノウハウをもとに、検査、スクリーニングから初期不具合解析、故障解析・原因解析、さらに各種デバイスへのデータ書き込み、レーザーによるマーキング、スティック、トレイ品からのテーピングなどの製品サポートを行っています。

NEXTY 34拠点

豊田通商グループの世界90か国以上に展開する海外ネットワーク

お客様へのきめ細かなサポートを実現するとともに新たなビジネスの創造を目指します。

- 大手半導体メーカーからユーザー海外生産拠点に販売
- 電子部品専用倉庫を設置(温湿度管理、静電対策、ロット管理)



キャッチフレーズに込めた想い

創るのはエレクトロニクスの未来だけではなく、人々の未来

競争がますます激化し、差別化が求められるエレクトロニクスビジネスにおいて、キャッチフレーズには一歩先ではなく、さらに次のフェーズを目指しているネクスティ エレクトロニクスの想いを込めています。使われている「未来」は、エレクトロニクスだけではなく、人々の未来も含めた広い意味を持つ言葉。日本、そして世界の未来を担う視点、さらには規模を備えた、ネクスティ エレクトロニクスだからこそ語ることができます。

お問い合わせ先/経営企画部 TEL.03-5462-9666

目次ページへ

ネクスティ エレクトロニクス
ホームページへ

OSRAM オプトセミコンダクターズ OSRAM特集 “Light is OSRAM”

OSRAM オプトセミコンダクターズ

ドイツ・ミュンヘンに本社を置くOSRAMは、2大照明メーカーのひとつです。その全額出資会社であるOSRAM オプトセミコンダクターズは、ドイツ・レーゲンブルクに本社を置き、可視光・赤外発光ダイオード、高出力レーザーダイオード、センサーを取り扱っています。生産拠点にドイツ・レーゲンブルクとマレーシア・ペナンに、北米の営業拠点をアメリカ・サニーベールに、アジアの営業拠点を香港に置き、世界中にセールスオフィスがあります。

会社紹介

会社概要

売上高	37億8,000万ユーロ(OSRAMグループ) (内：オプトセミコンダクターズ 14億2,500万ユーロ)
従業員数	約24,600名(OSRAMグループ) (内：オプトセミコンダクターズ 約10,500名)
世界の生産拠点 および営業拠点	約120カ国(OSRAMグループ) (内：オプトセミコンダクターズ：ドイツ レーゲンブルク、マレーシア ペナン、クリム(2017年稼働予定)、中国 無錫)
社名の由来	“OSRAM”の社名は、1919年当時の白熱電球のフィラメントの主材料であったOsmium(オスミウム)とタングステンのドイツ語WolfRAM(ヴォルフラム)の合成語に由来します。

歴史

OSRAM オプトセミコンダクターズの歴史

OSRAM オプトセミコンダクターズは世界のオプトエレクトロニクス業界においてトレンドを主導するパイオニア的存在です。

2016	マレーシア クリムの前工程工場着工
2014	中国の後工程工場稼働
2012	中国の後工程工場着工
2011	電球色LEDの研究所内での記録達成(142lm/W)
2008	白色パワーLEDで駆動電流 350mA時、効率136lm/Wの世界記録達成
2001	ドイツ レーゲンブルク新工場着工
1999	OSRAMとシーメンス ハルブレイトナーの合併で、OSRAMオプトセミコンダクターズ設立
1990	初の表面実装LEDがLED自動工程化の新しい世界標準確立
1988	SiC技術を使用した青色LEDの初のサプライヤーとなる
1984	ドイツ レーゲンブルクにLEDおよびレーザーエピタキシー用の初のクリーンルーム建設
1978	マレーシアにLED、赤外LED、オプトカラー、ディスプレイのアッセンブリーライン建設
1977	黄緑色GaPダイオードの初の量産
1972	ドイツ レーゲンブルクに初のLED、赤外LED、フォトダイオード、フォトトランジスタのアッセンブリーライン
1952	ドイツ エルランゲンのシーメンス研究所でハインリッヒ ヴェルカーがIII-V半導体を開発

OSRAM オプトセミコンダクターズの世界拠点



OSRAM オプトセミコンダクターズの主な製品

車載



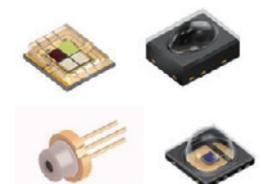
- 室内イルミネーション
- 前照灯および方向指示灯
- 赤外センサーおよび安全運転支援用途

民生



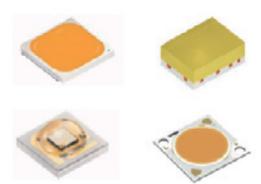
- モバイルの安全性：虹彩認証
- ウェアラブル：BioMon
- LEDフラッシュ
- LEDバックライト

産業



- ステージ照明
- ビデオウォール
- セキュリティ照明
- LEDまたはレーザープロジェクション

一般照明



- 室内照明：店舗、美術館、オフィス照明、住宅照明、レトロフィット
- 屋外照明：街路灯、建築照明

OSRAMの強み

封止材と光学系

- 透明性 > 99%
- 熱伝導性
- 耐光性
- 高屈折率 (> 1.54)

リフレクター

- 高反射性 (TiO₂ フィルター)
- 耐光性および耐熱性

熱管理

- 低熱抵抗 (R_{th}) の基板
- 耐腐食性
- 低熱抵抗 (R_{th}) 接続

蛍光体と変換

- 効率
- 熱管理
- 光学特性
- 色の安定性

OSRAMのノウハウ

- チップ材料、製造工程、チップ構造、光変換技術、パッケージ、光学設計まで深い専門知識と技術的リーダーシップ
- お客様との緊密な連携によるアプリケーション特化型設計

コンセプトエンジニアリング

- 知的所有権
- チップおよびパッケージ技術
- イノベーションマネジメント

エピタキシーとチップ設計

- 高反射性n型コンタクト
- ドループ現象の低減
- 低順電圧
- 光抽出

製造/加工

- コーティングと構造化
- 分離
- ダイとワイヤーボンディング
- 切断
- 試験

2020年までに30億ユーロの投資

- 研究開発に約20億ユーロの投資計画
- 新LEDチップ工場建設に10億ユーロを追加投資(世界最大級、最新の6インチウェファァー製造施設)



マレーシア・クリム工場 上棟式 2016年11月

お問い合わせ先/マーケティング第2部 OSRAMグループ TEL.03-5462-9687 salesosram@nexty-ele.com

OSRAM オプトセミコンダクターズ

オートモーティブ ～次世代を照らす先駆者～

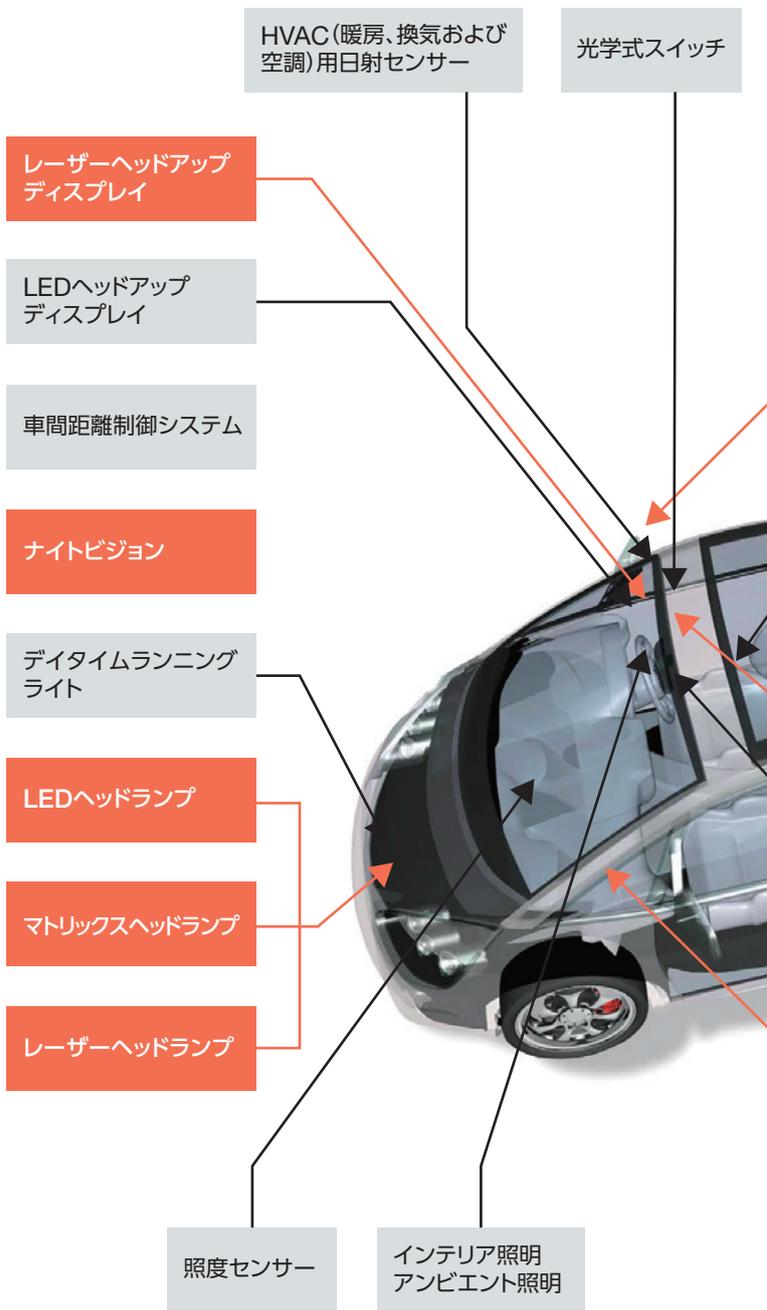
ヘッドアップディスプレイ

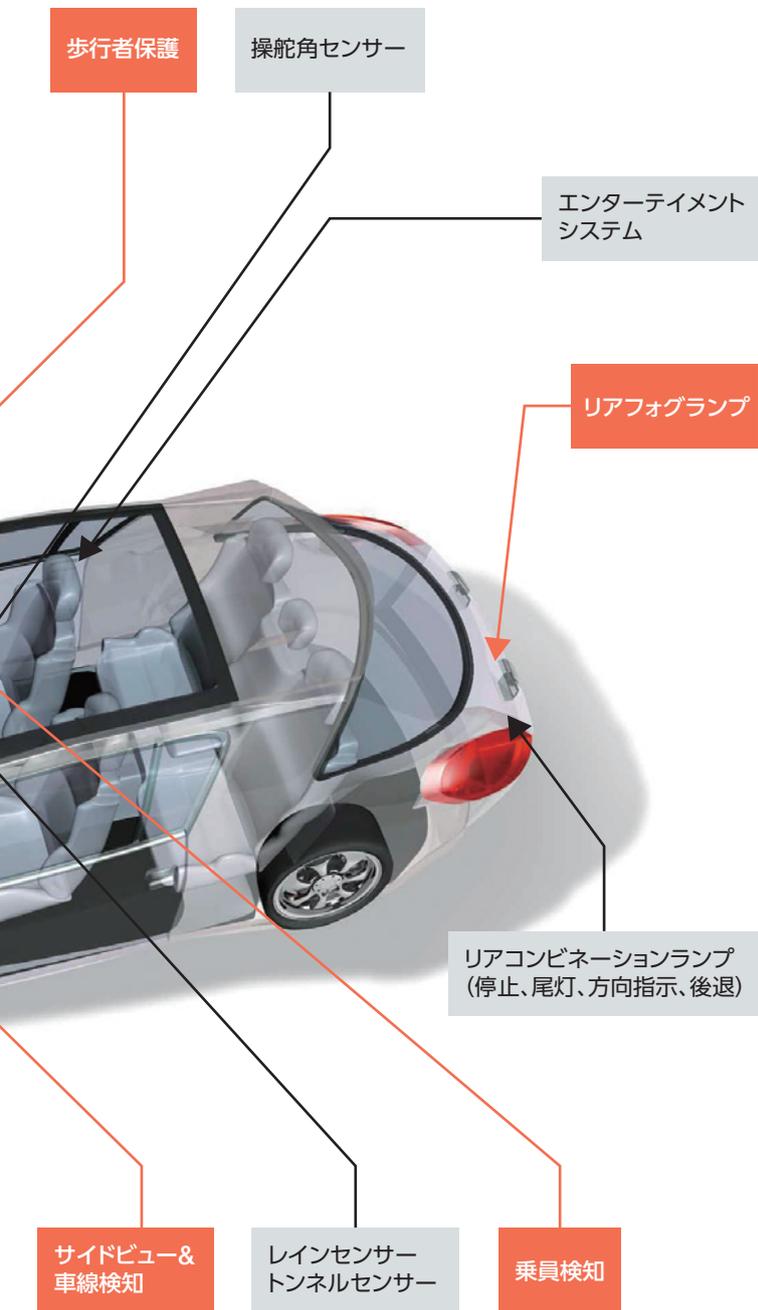
- マーケットニーズ：安全性と快適性の向上
 - OSRAMの優位性：高輝度、高効率
特にDLP向けに対しては高シェアを誇る
- ※HuD向けに、LEDのみならず、IR製品や可視光レーザーダイオードも保有(青、緑)



車間距離制御システム

- マーケットニーズ：車載品質レベルの低価格帯を実現
 - OSRAMの優位性：極めて短いパルス且つ4チャンネルレーザーを備えているため、車両の周囲を水平方向にスキャンすることができる
- ※写真は1チャンネル製品

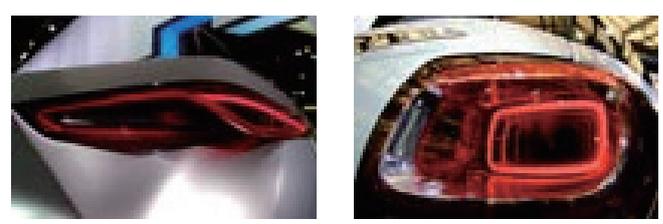




: 新しいアプリケーション
 : 既存のアプリケーション

リアコンビネーションランプ

- マーケットニーズ：ラインナップの多様性
- OSRAMの優位性：Advanced Power TOPLED®やSYNIOS® P2720をはじめとする、お客様のニーズに合う製品ラインナップ



マトリックスヘッドランプ

- マーケットニーズ：光源配置の柔軟性
- OSRAMの優位性：個別駆動・制御が可能なマルチチップ製品と省スペースで放熱性能の高いOSLON® Compact



お問い合わせ先／マーケティング第2部 OSRAMグループ TEL.03-5462-9687 salesosram@nexty-ele.com

モバイル機器向け赤外製品のご紹介

赤外LEDからセンサ、レーザーまで幅広い製品ラインナップの中からお客様に合ったソリューションをお探しいただけます。

	アプリケーション	生体認証 ・虹彩認証 ・顔認証	視線検出	ゼスチャーセンサー	ヘルスマーケティング ・心拍数 ・酸素濃度	レーザープロジェクション	近接センサー	リモコン
PL 450B Laser Diodes						✓		
PL 520B Laser Diodes						✓		
SFH 4045N CHIPLED® with lens								✓
SFH 4046 / SFH 4056 CHIPLED® with lens				✓				
SFH 4059 / SFH 4059S CHIPLED® with lens				✓			✓	
SFH 4140 T-MIDLED®								✓
SFH 4441 Mini MIDLED®								✓
SFH 4451 Mini MIDLED®							✓	
SFH 4645 MIDLED®								✓
SFH 4715S / SFH 4715AS IR OSLO® Black			✓					
SFH 4716S / SFH 4716AS IR OSLO® Black			✓					
SFH 4770S IR SYNIOS®			✓					
SFH 4780S IR OSLUX®		✓						
SFH 4786S IR OSLUX®		✓						
SFH 4787S IR OSLUX®		✓						
SFH 4796S IR OSLUX®		✓						
SFH 7050 / SFH 7051 BioMon Sensor					✓			
SFH 7060 BioMon Sensor					✓			
SFH 7070 / SFH 7072 BioMon Sensor					✓			

SFH 7070

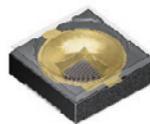
脈拍数および血液中の酸素濃度測定に最適な光学式センサー



パッケージサイズ	7.5mm × 3.9mm × 0.9mm
波長	530nm
駆動電流20mA時の光出力(緑色LED)	11.7mW
受光エリア	3.46mm ²

SFH 4796S

顔認証向け高出力赤外LED



パッケージサイズ	3.5mm × 3.5mm × 1.4mm
波長	850nm
放射強度	550mW/sr
駆動電流1A時の光出力	800mW

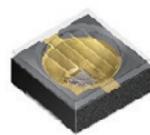
SFH 7060



パッケージサイズ	7.2mm × 2.5mm × 0.9mm
波長	530nm / 660nm / 940nm
駆動電流20mA時の光出力(緑色LED)	3.4mW
受光エリア	1.7mm ²

SFH 4787S

虹彩認証向け高出力赤外LED



パッケージサイズ	3.5mm × 3.5mm × 1.6mm
波長	810nm
放射強度	1,000mW/sr
駆動電流1A時の光出力	720mW

一般照明 ～より美しく照らすために～

照明向けLEDのご紹介

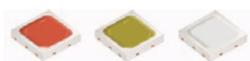
用途に合わせて、ローパワーからウルトラハイパワー、白からカラーまで幅広いラインナップの中からお選びいただけます。

住宅用照明

LED電球ダウンライト、スポットライト、スマート照明



— **DURIS® S5**
高効率、ミドルパワー



— **DURIS® S5 Color**
(Red, Blue, Green)
幅広い色のスペクトルソリューション



— **DURIS® S8 / DURIS® S10**
ローコスト、高出力タイプ(5W~10W)

施設、店舗用照明

ベースライト、蛍光灯、ダウンライト、スポットライトなど



— **SOLERIQ® シリーズ**
● 色の一貫性を実現 10°ビニング



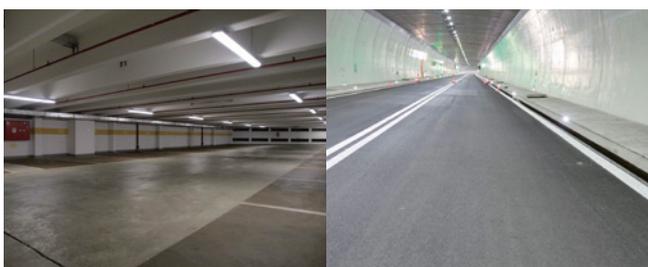
● 小型・高光束のチップオンボード
フィラメントタイプLED



— **DURIS® E5**
統一したパッケージで様々な効率の
ラインナップ
(ECO、STANDARD、PLUS)

屋外用照明

道路灯、防犯灯、投光器、トンネル灯など



— **OSLON® Square**
高効率(1~3W)、高信頼性、長寿命



— **OSLON® SSL 80/150**
高信頼性、長寿命、ユニークな配向特性



— **DURIS® P10**
高出力(8-9W)、高信頼性、長寿命

その他照明

植物育成、イルミネーション



— **OSLON® Color シリーズ**
(80°, 120°, 150°)
光合成促進の450nm、660nm、
発芽促進の730nm



— **DURIS® P シリーズ**
高信頼性のカラーLED

お問い合わせ先／マーケティング第2部 OSRAMグループ TEL.03-5462-9687 salesosram@nexty-ele.com

Texas Instruments社 シネマからオートへDLP®テクノロジー

デジタル映写機向けDLP Cinema®テクノロジーと同じ高画質なテクノロジーを車載分野に応用し、柔軟で高輝度なインタラクティブ・ディスプレイ・システムを実現。運転しやすさを、より向上させることができます。

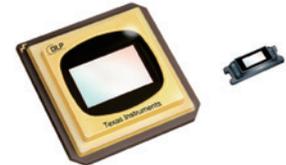
DLP®技術の仕組み

DLPチップセットは反射率の高いアルミニウム製マイクロミラー・アレイのデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)などの主要部品で構成されています。DMDは、電気入力/光出力のMicro-Electrical-Mechanical Systems (MEMS) 技術で、高速、高効率、高信頼性の空間光変調を実現します。TIの定評ある半導体製造能力を活用し、各DMDは関連CMOSメモリー・セル上部に組み込まれた最大800万個の個別制御マイクロミラーを使用しています。

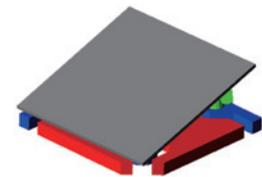
動作中に、DMDコントローラーは基盤となる各メモリー・セルに1または0をロードします。次に、ミラー・リセット・パルスを印加します。このパルスにより、各マイクロミラーはヒンジ部を中心にプラスマイナス数度という角度の状態に静電的に偏向されます。ばねの先端2箇所を物理的に止めるため、この2つの有効な状態の偏向角度は極めて高い再現性を持っています。

プロジェクション・システムでは、プラス数度の状態は「オン」ピクセルに対応し、マイナス数度の状態は「オフ」ピクセルに対応します。各ミラーのオン/オフ・デューティ・サイクルのプログラミングにより、グレースケール・パターンを生成できます。また、フルRGBカラー・イメージ生成のため、複数の光源は多重化が可能です。その他のアプリケーションでは、プラスマイナス数度の状態によって、あるパターンとその逆のパターンという2個の汎用出力ポートを提供します。

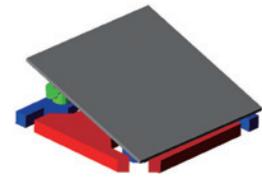
TIのDLP製品ラインアップは、 $\pm 12^\circ$ の状態と、 $\pm 17^\circ$ の状態を実現します。最新のTRPマイクロミラー・アーキテクチャは、 $\pm 17^\circ$ の状態も採用しています。この最新アーキテクチャは、良好な輝度と電力効率を必要とするポータブル機器に最適な、より小型のDMDを実現できることから、魅力的な選択肢を提供します。



ピコ・ディスプレイ向けのDMDの隣にあるのはデジタル・シネマ用DMDの画像です



-17度の状態にあるDLP TRPマイクロミラー



+17度の状態にあるDLP TRPマイクロミラー

DLP® ヘッド・アップ・ディスプレイ (HUD)



拡張現実(AR)対応のヘッド・アップ・ディスプレイにDLPテクノロジーを使うと、明るく、高輝度、視野角度の広い表示と同時に、仮想画像との距離を広げるフレキシビリティも実現し、ドライバーの自然な視線に表示することができます。

・広視野の表示

DLPテクノロジーを使用すると、最大で 12° という広い視野を確保できます。これは、現在市場で入手できるヘッド・アップ・ディスプレイの2倍を上回る広さです。視野を広げると同時に、仮想画像との距離を延ばすことで、HUD内に拡張現実アプリケーションを実装し、機能を強化することができます。

・鮮明なフルカラー・ディスプレイ

DLPヘッド・アップ・ディスプレイは、DLP Cinema®とフロント・プロジェクターと同じテクノロジーを採用しています。DLPテクノロジーによるヘッド・アップ・ディスプレイは、デジタル・ディスプレイと同じ、高輝度で正確な色表現を再現します。

・高効率でスケラブル

単一の低消費電力画像生成ユニット(Picture Generation Unit : PGU)がDLP HUDを駆動します。PGUは高効率であると同時にフレキシブルなので、さまざまな自動車モデルの多様なサイズの計器パネルに、同じPGUを組み込むことができます。

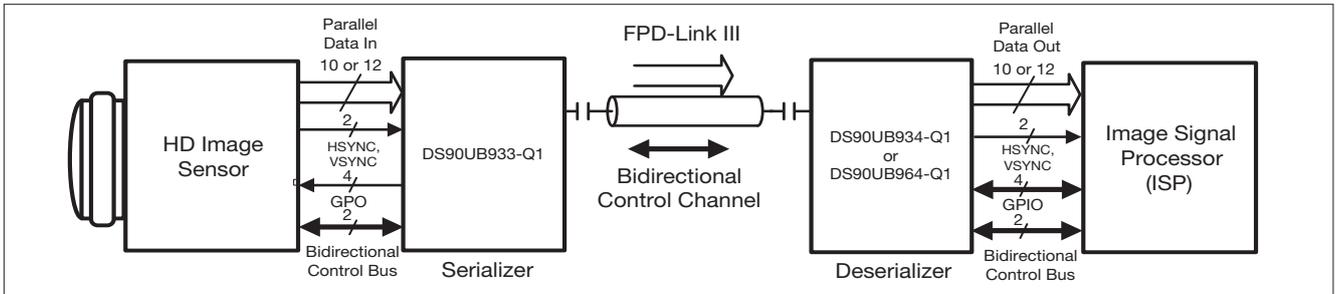
DLPはTexas Instrumentsの登録商標です。すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせ先／営業5部 51営業グループ TEL.052-558-4118

Texas Instruments社 カメラ向けFPD-LINK III

ADAS (先進的運転支援システム)や自動運転に向け、車両搭載カメラの数と解像度は年々増加しています。歩行者や障害物を事前に認識する為、最も重要な高速/高精度なデータ処理を強力にサポートする画像転送用FPD-LINK III製品をご紹介します。

DS90UB933-Q1/934-Q1 ~カメラ向けFPD-LINK III SerDes~



■特長

車載対応の高い信頼性

AEC-Q100認定済み

37.5MHz~100MHzの入力ピクセル・クロック(PCLK)をサポート

カメラの高解像度化に対応

同軸ケーブルによる電源重畳(PoC)

ケーブル本数の削減、コスト削減に効果

双方向制御インターフェイス・チャンネル

Back channelを使ってI²C、GPIOなどのデータの双方向通信可能

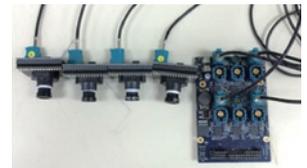
前世代とのコンパチビリティ(913A/914A)

934複製(レプリカ)機能

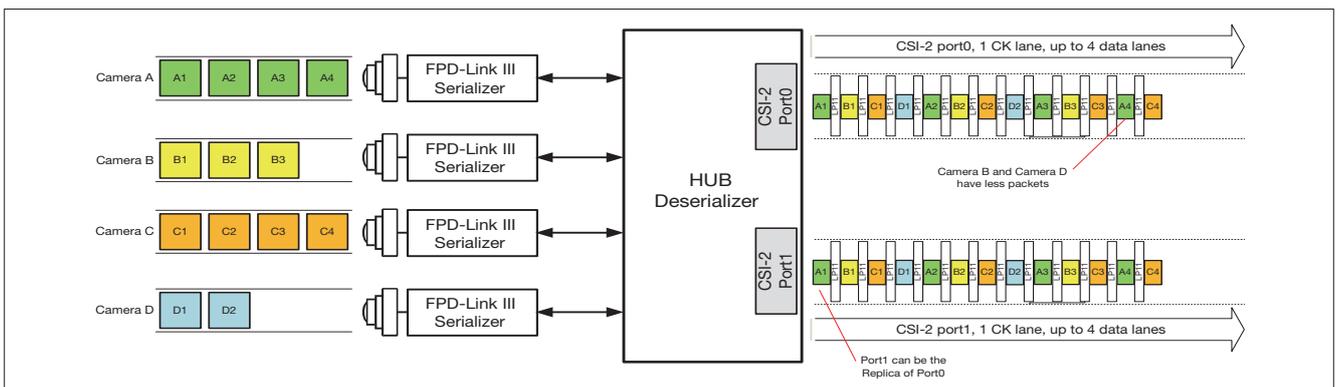
2つのプロセッサにビデオストリームを送ることが可能

■用途

- ・ サラウンド・ビュー・システム(SVS)
- ・ フロント・カメラ(FC)
- ・ リアビュー・カメラ(RVC)
- ・ センサー・フュージョン
- ・ ドライバー・モニター・カメラ(DMS)
- ・ リモート衛星レーダー、ToF、LIDARセンサー



DS90UB964-Q1 ~業界初デュアルポート出力、4チャンネルデシリアライザーHUB~



■特長

最大4つの2MPixelカメラ入力

2MPixel HD 60fpsをサポート

6.4Gbps MIPI CSI-2 デュアル出力ポート

1ポートに複数カメラ画像の集約、複製(レプリカ)出力モード

CSI-2バーチャルチャンネルをサポート

双方向制御インターフェイス・チャンネル(Back channel)

I²C、GPIOなどのデータの双方向通信可能

2ポートのI²C(1MHzまで)をサポート

934レプリケーション機能

2つのプロセッサにビデオストリームを送ることが可能

すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

ADAS SerDes Compatibility

				Deserializer		
				914A	934	964
				Parallel CMOS out	Parallel CMOS out	CSI-2 out
				10/12bit 100/75MHz	12bit 100MHz	2port x 6.4Gbps
Serializer	913A	Parallel CMOS in	10/12bit 100/75MHz	○	○	○
	933		12bit 100MHz	○	○	○

お問い合わせ先/営業5部 51営業グループ TEL.052-558-4118

Micron Technology 社 Micron社製 SSDラインナップのご案内

～このようなご経験はありませんか?～ =Micron社製品は、データの保存方法に変革をもたらします=

- SSDは製品ライフが長く、長期供給可能な製品を探している…
- 温度保証範囲の広いストレージが欲しい…
- 開発研究段階の為、幅広い製品情報を入手したい…

Micron Technology社について

- Micron社は、アメリカ・ボイジーに本社を置くDRAM・NOR・NAND・Module製品を取り扱う総合メモリーメーカーです。
- 2010年にNumonyx社を買収して以降、幅広いFlash製品を世界の様々な市場に供給しています。
- 高い品質を保つ為、前工程は全てMicron自社で行い、徹底した品質管理を実施しています。
- 安定した財務体質により積極的な技術投資が可能です。
次世代メモリーの開発に積極的に注力し先端技術を牽引しています。



SSDの採用が見込まれる市場

組込み系

放送機器
画像診断装置
産業用PC
セキュリティカメラシステム
ドライブレコーダー

Consumer



Client



データセンター系

HPC (High Performance Computing)
クライアントサーバー
ストレージ装置

Cloud



Enterprise



製品全般の特長

■特長1: 自社製NAND搭載

Micron社製SSDは、Micron自社工場で設計・開発・生産した自社製NANDフラッシュを搭載しています。

ハイパフォーマンス、高速なスループット、高信頼性を実現した製品です。

■特長2: 幅広いラインナップ

様々なご要望にお応えするため、コンシューマー向け製品、データセンター向け、産業機器向けのラインナップを取り揃えています。

注力製品紹介

■M500ITシリーズ

SLC NAND Chip/MLC NAND Chipを搭載したMicron社注力製品です
搭載NAND ChipはIndustrial Gradeの為、温度拡張を可能にしました
長期供給(4~5年)を実現し、製品ライフの長いアプリケーションに適しています

- ・容量: 32GByte~256GByte
- ・Form factor: 2.5inch/mSATA
- ・動作温度範囲: -40°C~+85°C



■5100シリーズ

先端技術3D NANDフラッシュを搭載したMicron社注力製品です
エンタープライズグレードサーバー及びシステムストレージの優れた性能を持ち合わせます
低コスト・高容量を実現します

- ・容量: 240GByte~7680GByte
- ・Form factor: 2.5inch/M.2
- ・動作温度範囲: 0°C~+70°C



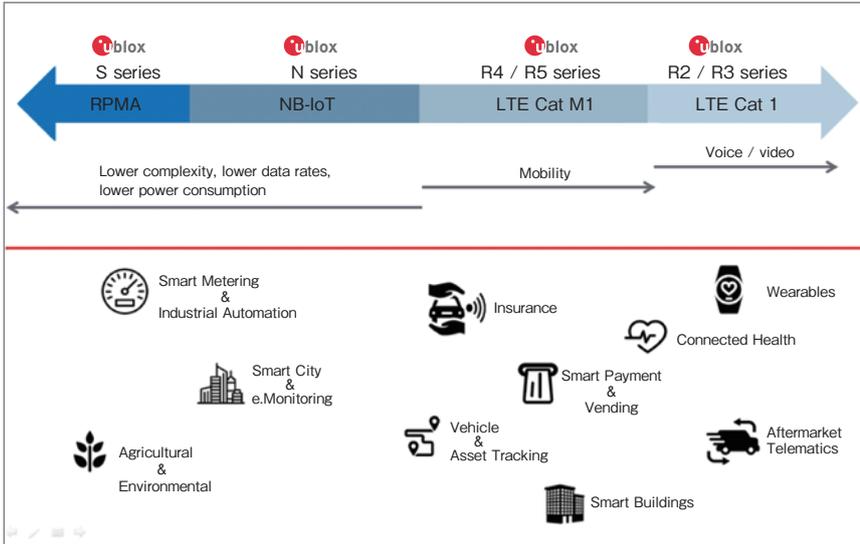
■データシートダウンロード先: URL:<http://jp.micron.com/>

お問い合わせ先/マーケティング第3部 TEL.03-5462-9653

u-blox AG社 u-blox社のLPWAソリューション

u-blox社のLPWA(Low Power, Wide Area)ソリューションで、広域かつ低消費電力のIoTネットワークを構築しませんか？
u-blox社は低速LTEのCat1、Cat M1、またNB-IoTに加え、アンライセンスバンドのRPMA方式まで、幅広いラインナップ
をご用意しています。スマートシティを実現するIoTアプリケーションの開発を加速させます。

ユースケースと市場に合わせ、最適な提案が可能です



製品ラインナップ

• LTE Cat 1

LARA-R3121 (GNSS搭載)
LARA-R2 シリーズ



サイズ 24×26×2.6mm

• LTE Cat M1

SARA-R4シリーズ



サイズ 16×26×3mm

• NB-IoT

SARA-N2シリーズ

• RPMA

NANO-S1シリーズ



サイズ 22.9×33×3.6mm

u-bloxのセルラーモジュールの優位性

1. セルラーモジュールのレイアウト互換

回路図、ガーバーファイル、部品表、PCBリファレンスデザインの提供可能
これにより、フォームファクターを超えて、スムーズなアップグレード/ダウングレードが可能

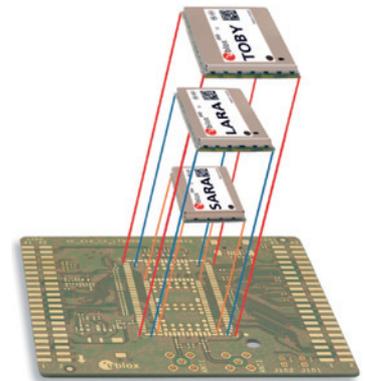
2. モジュール制御をするATコマンドも互換

ソフト資産の流用が可能

3. スケールメリットにより安価な製品の提供が可能

u-blox社は、2017年4月SIMCom社を買収しました
これにより製品ラインナップの拡充と共に、マーケットシェアがナンバー1になります¹

¹ Source: ABI 2016 2015 Cellular M2M Market Share by Units (%)



ラインナップ

					※	※
特長	Cat 1	Cat M1 (Full duplex)	Cat NB1 (NB-IoT)	RPMA	LoRa	SigFox
対象アプリケーション	Mobile connectivity / M2M	Mobile connectivity / M2M	M2M	M2M	M2M	M2M
ラジオスペクトラム	20MHz	1.4MHz	180kHz	80MHz	125kHz (typ)	600Hz
	3GPP Licensed	3GPP Licensed	3GPP Licensed	ISM Unlicensed Global 2.4GHz Band	ISM Unlicensed 868MHz (EU) / 915MHz (USA)	ISM Unlicensed 868MHz (EU) / 915MHz (USA)
サービス品質保証	○	○	○	○	×	×
反応時間	ミリ秒	ミリ秒	秒～分	秒	秒～分	秒～分
ローミング	グローバル	グローバル	グローバル	グローバル	ローカル	単一ネットワーク
ピークデータレート	5Mb/s (UL)	1Mb/s (UL)	62.5kb/s (UL)	15.6kb/s (UL)	5.5kb/s (125-bw)	100kb/s (UL)
	10Mb/s (DL)	1Mb/s (DL)	27.2kb/s (DL)	31kb/s (DL)	50kb/s (500-bw)	500kb/s (DL)
FOTA	○	○	○	○	×	×
音声サポート	○ (VoLTE)	○ (VoLTE)	×	×	×	×
バッテリー寿命	5年	5～10年	10年+	10年+	10年+	10年+
コストイメージ	\$\$\$	\$\$	\$	\$+	\$	\$

注: u-bloxプレゼンテーション資料より抜粋 (和訳)

※ LoRa, SigFoxのソリューションはありません。

お問い合わせ先/マーケティング第5部 通信プロダクトグループ TEL.03-5462-9724

VISHAY Intertechnology社 極薄/超低背0.8mm IRレーザモジュール「TSOP57x」シリーズ

半導体・電子部品の総合メーカーであるVishay社より今回ご紹介するのはIRレーザモジュール『TSOP57x』シリーズです。Vishay社はオプトエレクトロニクス(光半導体)分野でも世界的にトップレベルのシェアを持っており、赤外線(IR)関連の製品を多数取り揃えています。

『TSOP57x』シリーズは低背(0.8mm)で低消費電力、外来ノイズへの耐性も高く、幅広い製品優位性を持ち合わせます。

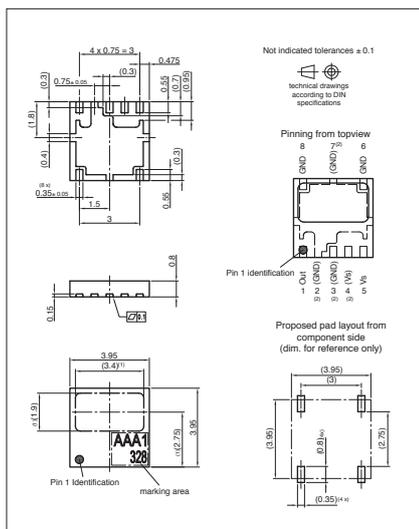
概要

Vishay『TSOP57x』シリーズIRレーザモジュールは、PCM周波数用の内部フィルタを備えたフォトディテクタとプリアンプを1パッケージにして提供します。Vishay『TSOP57x』IRレーザモジュールは、非常に低い消費電流と、2.5V~5.5Vの電源電圧範囲を備えています。このデバイスは、周辺光や無線に対するノイズ耐性が向上しており、電圧リップルおよび、これら外来ノイズに対して高い耐性を備えています。

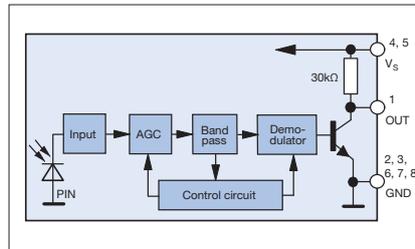
特長

- ・ HF、RFノイズに対する耐性の向上
- ・ 高さ0.8mm
- ・ ±75°の半角感度
- ・ 低消費電流
- ・ フォトディテクタとプリアンプ、PCM周波数用の内部フィルタを1パッケージに内蔵
- ・ 電源電圧:2.5V~5.5V、Typically 2.0V~5.5Vが可能
- ・ 光学ノイズに対する耐性の向上
- ・ 電源電圧リップル、ノイズへの高い耐性

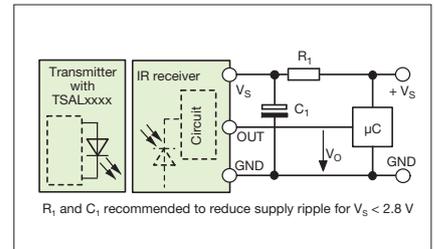
パッケージ



ブロックダイアグラム



アプリケーション回路図



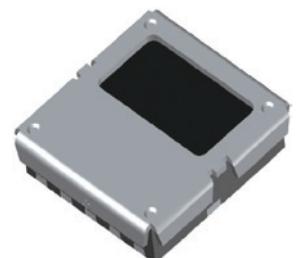
絶対定格値

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Supply voltage		V_s	-0.3~+6	V
Supply current		I_s	5	mA
Output voltage		V_o	-0.3~($V_s+0.3$)	V
Output current		I_o	5	mA
Junction temperature		T_j	100	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-25~+85	°C
Operating temperature range		T_{amb}	-25~+85	°C
Power consumption	$T_{amb} \leq 85^\circ\text{C}$	P_{tot}	10	mW

Note Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect the device reliability.

電気的特性 ($T_{amb}=25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply voltage		V_s	2.5	-	5.5	V
Supply current	$V_s=5\text{V}, E_v=0$	I_{SD}	0.55	0.7	0.9	mA
	$E_v=40\text{kIx}$, sunlight	I_{SH}	-	0.8	-	mA
Transmission distance	$E_v=0$, IR diode TSAL6200, $I_f=250\text{mA}$, test signal see Fig. 1	d	-	40	-	m
Output voltage low	$I_{OSL}=0.5\text{mA}$, $E_e=0.7\text{mW/m}^2$, test signal see Fig. 1	V_{OSL}	-	-	100	mV
Minimum irradiance	Pulse width tolerance: $t_{pi} - 5/f_o < t_{po} < t_{pi} + 6/f_o$, test signal see Fig. 1	$E_{e\ min.}$	-	0.2	0.4	mW/m^2
Maximum irradiance	$t_{pi} - 5/f_o < t_{po} < t_{pi} + 6/f_o$, test signal see Fig. 1	$E_{e\ max.}$	50	-	-	W/m^2
Directivity	Angle of half transmission distance	$\phi_{1/2}$	-	±75	-	deg



■参考まで TSOP57*..H より外来ノイズに強い、メタルシールド品もあります

お問い合わせ先/マーケティング第5部 Vishayグループ TEL.03-5462-9629

システムコストダウンをご提案 インフィニオン社製Smart IPM [iMOTION] 待望のリリース

この度インフィニオン社からSmartIPM「iMOTION」がリリースされます。
この「iMOTION」をご使用して頂く事により、お客様に次の3つの価値をご提案します。

SmartIPM [iMOTION] が提供する3つの価値

システムコストの削減

- ①R&Dコスト削減
高集積化製品+十分にテストしたBLDC用ソフトウェア→設計リソース及び時間を劇的に削減
- ②部材費の削減
高集積化製品→外付け部品、PCBサイズの削減
- ③製造コストの削減
高集積化製品+十分にテストしたBLDC用ソフトウェア→製造の信頼性を向上させ物流の簡素化

商機を逃さない Time To Market

- ・ BLDC制御
各製品内部にセンサーレスBLDCを内蔵
最新の生産準備が整います
- ・ エコシステム設計の簡素化
モーターアプリケーションの適合のエコシステム、テストが簡単に使えます

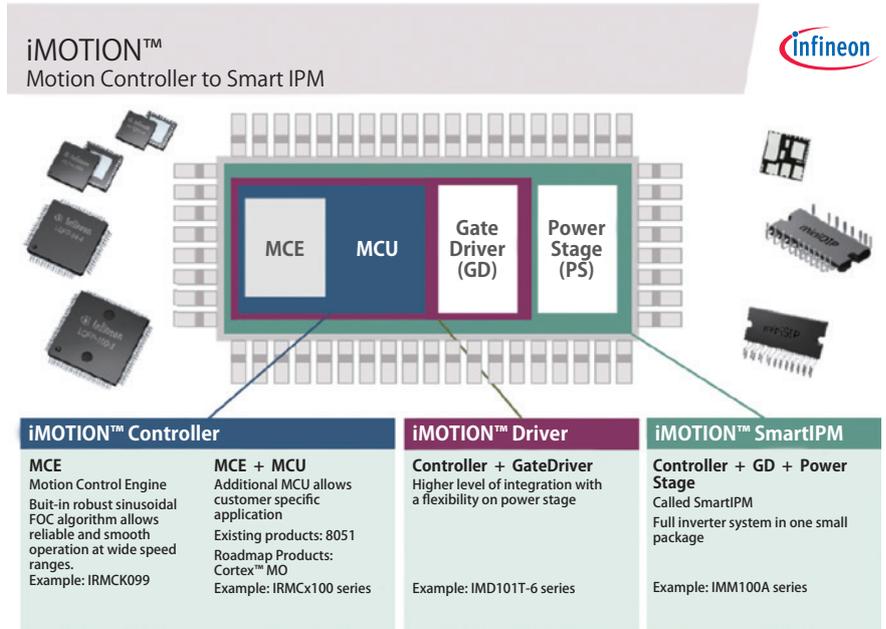
System Benefit

- ・ ハイスピードセンサーレスFOC
- ・ ハードウェア+アルゴリズムが効率を増加
- ・ アルゴリズムがスムーズな操作と低い音響ノイズを保証します

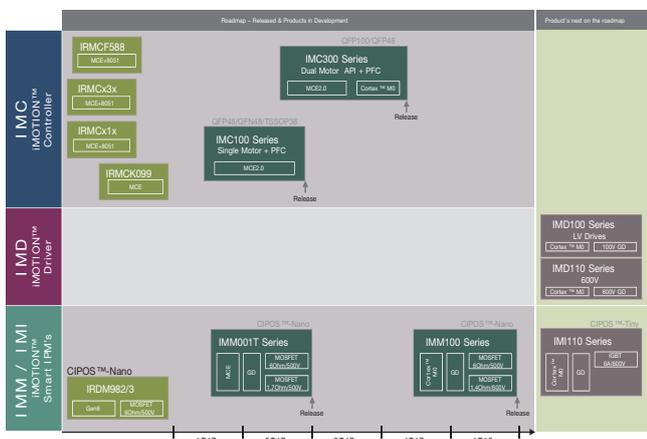
ターゲットアプリケーション

- ・ ホームアプライアンス
- ・ エアコンディショナー
- ・ ファン、ポンプ、コンプレッサー
- ・ ドローン

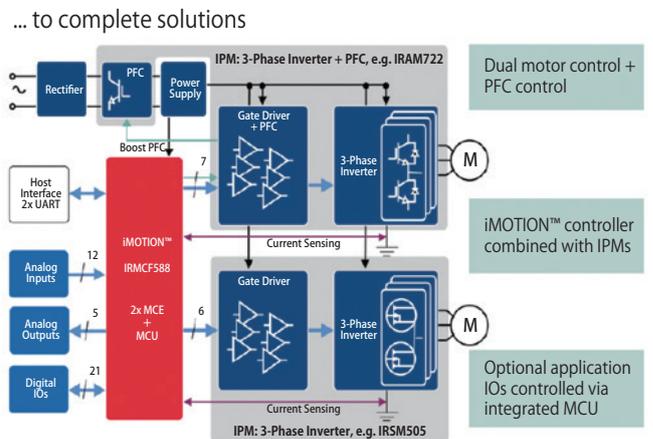
iMOTION



iMOTIONロードマップ



iMOTIONを使用したブロック図例



Maxim Integrated社 SDR用ラジオチューナー

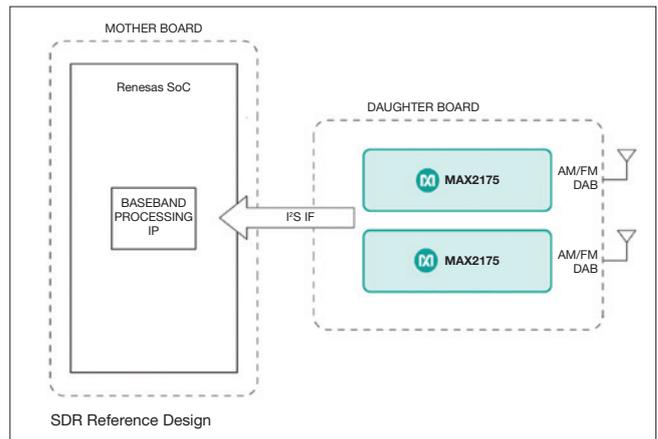
Maxim社のSDR(ソフトウェア定義ラジオソリューション)における技術により、全世界のラジオ規格に対応した共通のハード設計が可能となります。Maxim社のRF to Bits®チューナーは、SDRをご検討のすべての車両アプリケーションに対し、設計の柔軟性、スペースの節約、パフォーマンスの向上を提供します。

製品特長

- ・品番：MAX2175
- ・幅広いラジオ規格に対応
(AM/FM/DAB/DRM/HD/DMB/Weather Band)
- ・MRC、FM Diversity、Dual DAB、DAB-FM、DAB-DAB受信対応可能
- ・小型パッケージ(7mm×7mm、48ピンTQFN)
- ・単一電源電圧:+3.3V
- ・VHF-IIIバンドループスルー内蔵
- ・AM中波帯の全帯域を受信
- ・全デジタル利得制御
- ・各種設定可能なワード長
- ・デュアルまたはシングルデータラインモード

製品を含むMaxim製品の情報、詳細に関しましては下記
同社ホームページご覧下さい。
Maxim社：<https://www.maximintegrated.com/jp.html>

標準ブロック図

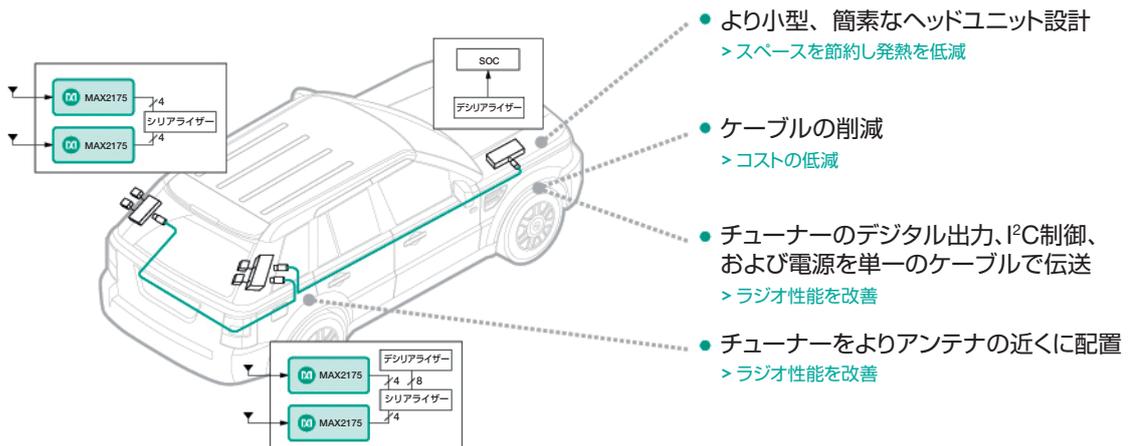


MAX2175を応用したリモートチューナー技術

Maxim社のリモートチューナーアーキテクチャーは、ヘッドユニットの設計を簡素化するとともに、ラジオの信号クオリティを向上させ、コスト、重量、および消費電力削減が可能です。具体的にはMaxim社SerDes製品(GMSL)を使用し、受信した信号をシリアルライズし、単一の同軸ケーブルでヘッドユニットに送信します。この同軸ケーブルは、I2C通信および電源供給も可能です。

その結果、より小型、低発熱のヘッドユニットが実現し、ケーブル数が大幅に削減されます。デジタル信号は環境ノイズに対する耐性が高いため、信号クオリティおよび微弱信号の受信が向上します。

もう一つの特長は、スケーラビリティです。ヘッドユニットの設計を変更することなく、非常に容易にバックグラウンドスキャンおよびフェーズダイバーシティ用のチューナーを追加することができます。



■その他製品ラインナップ

Part	Supported Standards	Supported Frequency Bands (MHz)	Comments
MAX2175	AM/FM/DAB/DAM/HD/DMB/Weather Band	0.144 to 26.1, 76 to 108, 168 to 240, 1452 to 1492	RF to Bits automotive-grade receiver for AM/FM/DAB/DRM/HD/DMB/Weather Band
MAX2173	DAB, T-DMB	76 to 108, 168 to 240, 1452 to 1492	RF to Bits automotive-grade receiver for DAB and T-DMB
MAX2172	DAB, T-DMB	87 to 108, 168 to 240, 1452 to 1492	Includes buffered reference clock
MAX2170	DAB, T-DMB	168 to 240, 1452 to 1492	Includes clock reference buffer

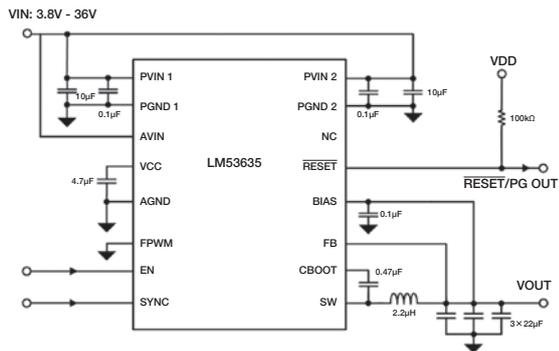
お問い合わせ先／マーケティング第5部 Maximグループ TEL.03-5462-9719

Texas Instruments社 車載向けDCDCコンバーター

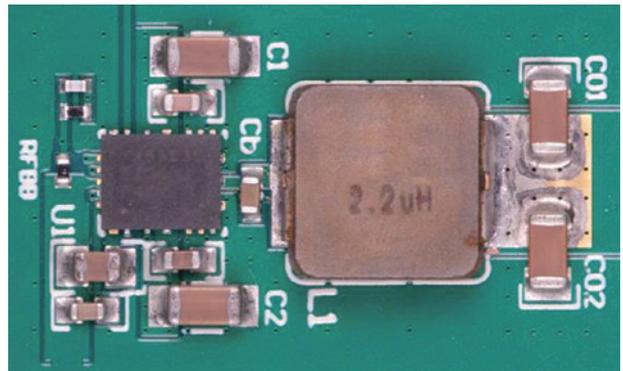
車載向けDCDCコンバーターにおいては、使用されるアプリケーションによって様々な性能と機能が求められます。幅広く使用できるTIのDCDCコンバーターとノイズ特性を向上させたHot Rodパッケージをご紹介します。

LM53625/35-Q1 2.5/3.5A 2.1MHz DCDCコンバーター

Typical Application Circuit



Typical Automotive Layout (22mm×12.5mm)



■特長 機能概要

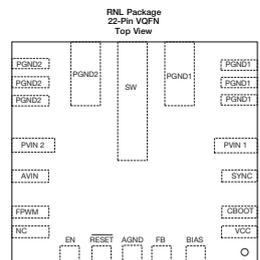
- 入力電圧範囲：3.5V~36V(絶対最大定格 42V)
 - 出力電圧：3.3~10V(ADJタイプ) 3.3V、5V(FIXタイプ)
 - FB電圧精度：±1.5%(全温度範囲)
 - 静止電流：15uA typ
 - 最小ON時間：60ns max
 - 最大98% Duty 動作
 - 軽負荷時効率：1mA(80%)
- 車載仕様に特化した各種機能**
- 外部同期機能
 - 強制PWMモード機能(ピン選択可能)
 - スペクトラム拡散機能(パッケージオプション)
 - 0.6V低ドロップアウト動作(3.5A Ta=105°C)

小型のソリューションを実現

- FET・位相補償内蔵
- スイッチング周波数 2.1MHz
- 4mm×5mm VQFN/パッケージ(Hot Rod)
- 動作温度範囲：Tj: -40°C~+150°C

■用途

- ・車載テレマティクス
- ・車載インフォテインメントシステム
- ・車載クラスターシステム
- ・ADASシステム



その他注目製品

Hot Rodパッケージ ~放熱・ノイズ(EMI)特性の向上~

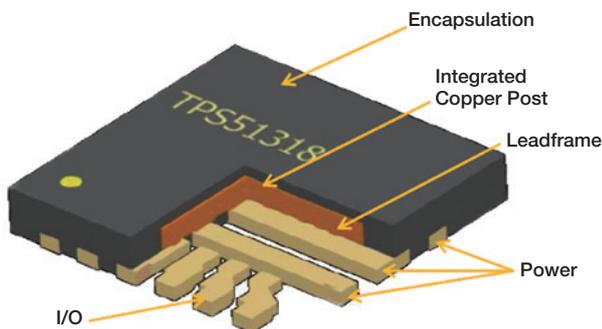


図1. HotRod QFN Structure and Die Attachment

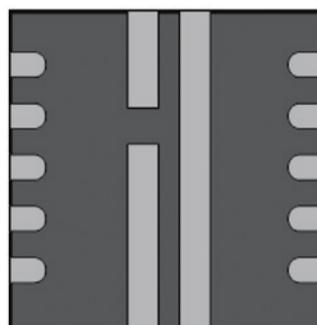


図2. Package Outline

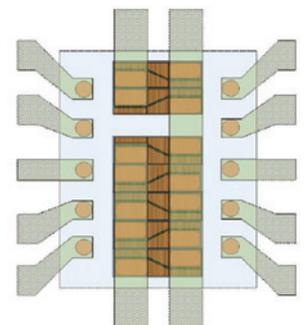


図3. Die to Leadframe Interface

ボンディングワイヤを使用せずリードフレームとダイを直接接続することにより、従来のパッケージに比べて低ON抵抗と低インダクタンスを実現しております。特に電源製品に採用することにより優れた電気的特性と放熱特性を提供します。

■特長

- ・低ON抵抗 ⇒高効率
- ・低インダクタンス ⇒EMI特性の向上
- ・高い放熱特性

すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

お問い合わせ先/営業5部 51営業グループ TEL.052-558-4118

STマイクロエレクトロニクス社 SiCパワーMOSFET/AEC-Q101車載対応SiCダイオード

STマイクロエレクトロニクス社からは、卓越した電力効率と信頼性を特長とするSiC(炭化ケイ素)パワーMOSFETと、パワーコンバータの性能を大幅に高めるAEC-Q101車載対応SiCダイオードをご紹介します。

革新的な高耐圧スイッチングを実現するSiCパワーMOSFET

STは、高耐圧SiCパワーMOSFETを初期の段階から生産してきた企業の1社です。SiCパワーMOSFETは、シリコン(Si)パワーMOSFETと比較よりもスイッチ損失が大幅に低く、温度による変動も最小限に抑えることができます。

ワイド・バンドギャップ材料の先進的で革新的な特性をベースにするSTのSiCパワーMOSFETは、1200V定格での非常に低い面積当たりのオン抵抗と優れたスイッチング性能を融合させ、より効率的かつ小型の設計を可能にします。また、業界で最も高い200°Cの温度定格により、システムの熱設計を改善します。

利点

- ・実装面積の小型化とシステムの軽量化
- ・受動部品のサイズ/コストの低減
- ・システム効率の向上
- ・必要な冷却の軽減とヒートシンクの小型化

SiCパワーMOSFET

品名	V _{DSS} (V)	I _D max(A) (@ 25°C)	R _{DS(on)} max(mΩ) (@ V _{CS} =20V)	Q _g typ(nC)	T _J max(°C)	パッケージ
SCT10N120	1200	12	0.69	22	200	HiP247™
SCT20N120	1200	25	0.239	45	200	HiP247™
SCT30N120	1200	45	0.1	105	200	HiP247™
SCT50N120	1200	65	0.069	122	200	HiP247™
SCTWA50N120	1200	65	0.069	122	200	HiP247™ long leads

パワー・コンバータの性能を大幅に高めるAEC-Q101車載対応SiCダイオード

STのSiCダイオードは、ワイド・バンドギャップにより、温度に関係なく、ターン・オフ時の逆回復電流と容量性ターン・オフ特性をごくわずかに抑えた高耐圧ショットキー・ダイオードによる設計を可能にします。STの高性能パワー・ショットキー・ダイオードは、最大650Vに対応可能で、市場で最も低い順方向降下(V_F)により、高い効率を実現します。

STは、世界で初めてAEC-Q101認定取得とPPAP対応のSiCダイオードを提供したメーカーです。

利点

- ・高効率によりパワー・コンバータに付加価値を提供
- ・パワー・コンバータのサイズ/コスト削減
- ・低いEMC特性により、認定取得を簡略化し製品開発期間を短縮
- ・高い堅牢性により、高い信頼性を保証

AEC-Q101車載対応SiCダイオード

品名	定格電流(A)	定格電圧(V)	パッケージ
STPSC12065DY	12	650	TO220AC
STPSC20065DY	20	650	TO220AC
STPSC20065WY	20	650	DO247
STPSC40065CWY	40	650	TO247

お問い合わせ先/マーケティング第2部 STグループ TEL.03-5462-9622

Sierra Wireless社 W/W対応Sierra Wireless社のSIM製品

Sierra Wireless社のSIMソリューションは世界各国でのキャリアローミングに対応しており、1枚でワールドワイドでの運用が実現可能です。製品の海外展開に際して最適なソリューションとなっております。

Sierra Wireless社 SIMの特長

1 マルチオペレーター対応

Sierra Wireless社と複数のオペレーターとの契約により1枚のSIMで複数のオペレーターの使用が可能です。これによってより効率的なオペレーターの選択が行われコスト的にもメリットがあります。

2 スマートネットワークセレクション

通信状態、コストが最適なオペレーターに自動で接続する事により、より効率的な運用の手助けを行います。

3 コネクション停止時の復帰

使用しているオペレーターのネットワークが停止または圏外になった時には、コネクション可能なネットワークを素早く探し出し、コネクションを確立します。

4 最適な料金体系

グローバルでの使用を考慮した料金プラン以外にも主に特定の地域での使用を想定したお客様に最適な料金プランを選択可能です。

5 eSIM/eUICCへの将来的な対応

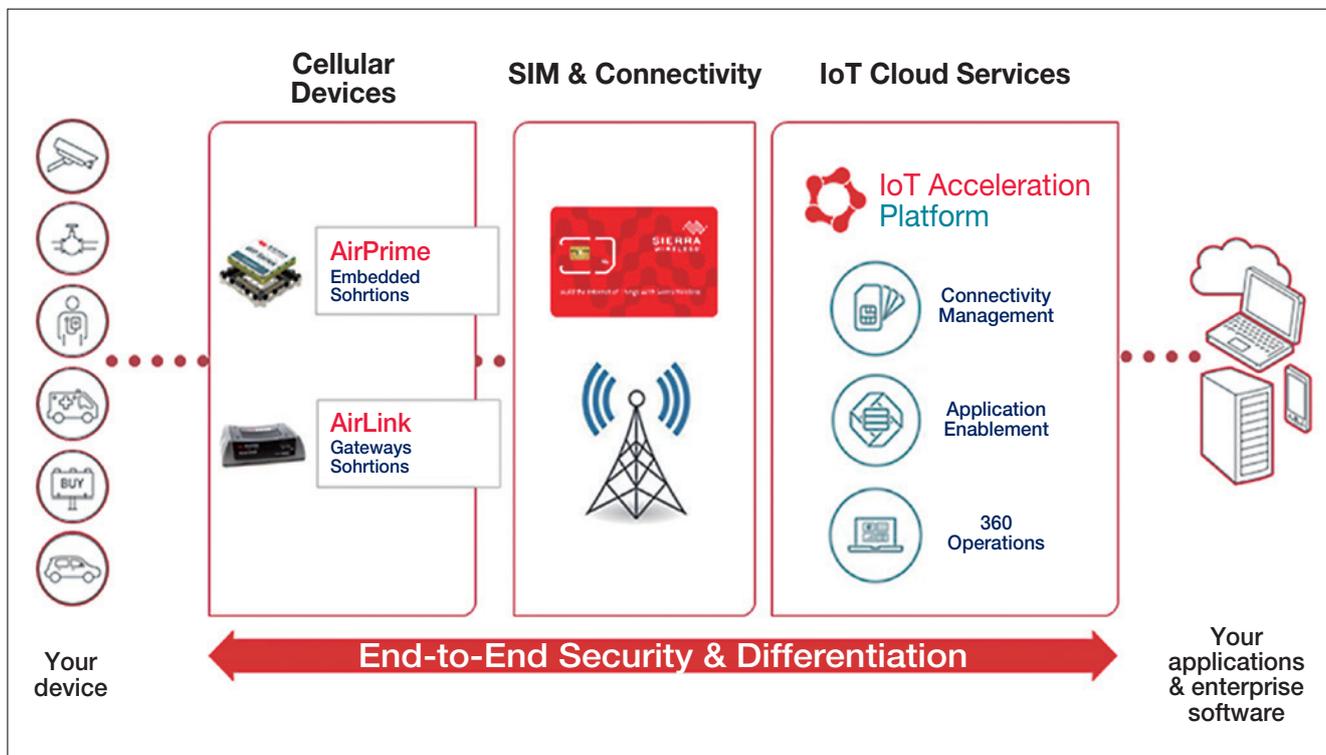
GSMA規格に準拠した埋め込みSIMへの対応を今後予定しています。

6 SIMの一元管理

Sierra Wireless社のIoTプラットフォームであるAirVantageを使用して世界中のSIMの状態を管理する事が可能です。



運用例



取扱い製品一覧

半 導 体

ASMedia Technology Inc.

デジタル高速インターフェースSATA、PCI Express、USB3.0/3.1コントローラ、Hub、マルチプレクサ製品

DSP Group, Inc.

コードレス用BB/RF IC、Home Appliance Network用IC、音声トリガーデバイス

Elite Semiconductor Memory Technology Inc.

低容量DRAM (SDRAM/DDR1/DDR2/モバイルSDRAM/モバイルDDR)、NAND型フラッシュメモリー及びNANDベースのMCP、SDRAM、DDR1、DDR2のKGD製品

Infineon Technologies AG P16

車載用半導体(レギュレーター、DC/DC、ハイサイドSW、ローサイドSW、FET、ブリッジ、GMR、ホールセンサー、Driver IC、CAN、LIN)、32bitマイクロコントローラ(ARM)、パワーデバイス(高耐圧パワーMOSFET、低電圧パワーMOSFET、電源制御用IC、IGBT、IBGTモジュール)、IPM、高周波ディスクリート(移動体通信用)、NFC、TPM、Chip Card & セキュリティー製品

Linear Technology

高性能アナログ半導体他

Maxim Integrated P17

セキュアマイコン、認証IC、生体センサー、ジェスチャーセンサー、ガスセンサー、1-wire、SerDes、I/O LINK、大電流電源IC、データコンバーター、オペアンプ、インターフェイス、RF IC、バッテリー管理IC、チューナーIC、リファレンス、光トランシーパー、ストレージ、パワーマネージメント、T/Eキャリアトランシーパー、センサー、スイッチ、マルチプレクサー、クロック及び発信機、モデムIC、スマートキー、高耐圧電源IC

Micron Technology Inc. P13

DRAM、LPDRAM、DRAM Module、NOR Flash、NAND Flash、eMMC、MCP (NVM+RAM)、PCM、SD Cards、SSD

NEXPERIA B.V

ロジックIC、MOS-FET、小信号トランジスター、ダイオード

NVIDIA Corporation

グラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)、グラフィックスボード、SoC

NXP Semiconductors

【オートモーティブ】マイクロコントローラ/プロセッサ、セーフティ・ボディ・パワートレイン向けASSP、カーオーディオ用DSP、カー・チューナー専用IC、車載ネットワーク用IC (FlexRay、CAN、LIN、SBC)、各種センサー、キーレスエントリー/リモビライザー/MOSFET、RF、パワーマネージメントIC

【マルチマーケット】ARMマイコン、NFC、各種ICバス用IC、電源コントローラIC、RFディスクリート、RTC、LEDドライバー・コントローラ

OSRAM Opto Semiconductors GmbH P5~10

面実装LED、赤外発光素子、半導体レーザー

Qualcomm

Bluetooth、WiFi、GNSS、等通信系半導体

STMicroelectronics N.V. P19

車載向けIC

8bit(自社)/32bit(PowerPC、ARM)マイコン、ボディ・パワートレイン・セーフティ向け各種ASSP、GNSS、オーディオパワーアンプ、チューナーIC、MOSFET、IGBT、ダイオード、LEDドライバー、レギュレーター、EEPROM、セキュアメモリー、モーションMEMSセンサー、高精度オペアンプ/コンパレーター/電流センサアンプなど

非車載向けIC

8bit(自社)/32bit(ARM)マイコン、セキュアマイコン、メモリー(EEPROM)、モーションMEMS、環境センサー、ToF測距センサー、MEMSマイク、アンプ&コンパレーター、RF(BluetoothLE、NFC、Sub GHz帯、PLLシンセ他)、モータドライバー、LEDドライバー、MOSFET、IGBT、ダイオード、トリアック、サイリスタ、電源用IC(AC/DC、DC/DC、チャージャ等)、USB PD、I/Oリンク、保護素子、シリコンフォトニクス、プロセスファウンドリ

TDK MICRONAS GmbH

リニアホールセンサー、ホールスイッチ、360度角度センサー、3相BLDCドライバー内蔵12V直結8-bitマイコン、デジタル出力の電流トランジェューサー

Texas Instruments Incorporated P11、12、18

アンプ、オーディオ、クロック/タイミング、データ・コンバーター、DLP®製品、インターフェイス、アイソレーション、ロジック、モータ・ドライバー、電源IC、組込みプロセッサ、RFとマイクロ波、センサ製品、スイッチ/マルチプレクサ、ワイヤレス・コネクティビティ

VISHAY Intertechnology, Inc. P15

シリコニクス(パワーMOSFET、アナログスイッチ、パワーIC、スマートロードスイッチ)、ダイオード製品(パワーダイオード、整流素子、サージ吸収素子、ブリッジダイオード)、オプトエレクトロニクス製品(赤外線発光素子、IrDA製品、近接・照度センサー)受動部品(インダクター、精密抵抗、大容量キャパシタ、巻き線抵抗、MELF抵抗、タンタルコンデンサー)

ザイリンクス

FPGA、Logic製品(Spartan6、Artics7)、ARM Core内蔵したMPSOC(Zynq Ultra Scale+)

愛知製鋼株式会社

地磁気センサー(MIセンサー)

電子部品 ボード類・機器・その他

AU Optronics Corporation

液晶ディスプレイパネル(産機、車載、アミューズ、サイネージ向け等)、タッチパネル

Career Technology (Mfg.) Co., Ltd.

FPC、リジッドフレキ

LEM Holding SA

高性能電流センサー

日本シイエムケイ株式会社

プリント配線板

NEC Energy Solutions, Inc.

リン酸鉄リチウムイオン蓄電池モジュール
12V 5Ah仕様: ALM12V7s、ALM12V7sHP
12V 35Ah仕様: ALM12V35s、ALM12V35iCANbusHP、ALM12V35iSMbusHP

Payton Planar Magnetics Ltd.

カスタム平面型トランス、カスタム平面型インダクター、カスタムトランス+インダクター一体型製品

POLYMATECH JAPAN CO.,LTD.

静電容量タッチスイッチセンサーシート、放熱シート、樹脂成型、ラバー成型

Power Integrations, Inc. (IBCT-Concept)

IGBTドライバーボード、AC/DCコントローラIC

Seagate Technology

ハードディスクドライブ(HDD)、PCIe SSD、SAS SSD、ストレージシステム

Sierra Wireless Inc. P20

広域無線通信(LTE/UMTS/HSDPA、Edge/GPRS、EV-DO/CDMA)モジュール、M2Mソリューション

新電元工業株式会社

ダイオード、FET、バリスタ、電源モジュールサイリスタ、IGBT

新日本無線

各種半導体(オペアンプ/コンパレーター・電源IC・オーディオ/ビデオIC・他)

Toyo Aluminium K.K.

AL RFID/AL+PET FPC/AL+PI FPC/CU+PI FPC/電磁波シールド/導電性接着剤/導電性ペースト/ALペースト伸縮配線板/AL箔インサート成形品

TTM (Viasystems)

両面~10層貫通基板、厚銅多層基板、HDI基板

u-blox AG P14

マルチGNSS(GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応)レシーバーIC及びモジュール製品、推測航法ソリューション(3Dセンサー内蔵モジュール等)、RTKモジュール、eCall/ERA-GLONASS対応ワイヤレス通信モジュール(GSM/GPRS、UMTS/HSPA+、LTE Cat.1/4/6)、近距離無線モジュール(Classic Bluetooth、Bluetooth low energy v4.2、WLAN.11a/b/g/n/ac、V2X向け.11p)

Unimicron

両面~8層貫通基板、Semi Flex基板、Rijid Elex基板、銅インレイ基板、厚銅多層基板、HDI基板、高周波対応異種積層基板

Yes Optoelectronics Co. Ltd

カスタムLCDパネル(LCDタイプ:TN、HTN、STN、FSTN、DSTN、DFSTN、ESTN、ASTN、VA、FS)、モノクロTFTパネル、カラーTFTパネル、バックライトLEDモジュールなど

ネクスティ エレクトロニクス企画製品

自社開発製品

IoT/M2M分野に向けモバイルアダプタ

新たなサイネージシステム

スマートコムサイネージ®



NEXTY Electronics
A Toyota Tsusho group company



トーメンエレクトロニクスと 豊通エレクトロニクスは、 「ネクスティ エレクトロニクス」になりました。

国内最大、車載分野では世界最大のエレクトロニクス商社「株式会社ネクスティ エレクトロニクス」が誕生します。

それぞれの強みを結集し、**技術と機能**の強化を進める私たちの歩みは、世界中のニーズに確実に応えとともに、

それに先んじて社会課題を解決するソリューションを提供するためのもの。

もっと豊かで、楽しい未来をNext Technologyでネクスティ エレクトロニクスが見つめる明日がここにあります。

次の、未来へ。

株式会社ネクスティ エレクトロニクス
代表取締役社長

青木 厚

次の、未来へ。



株式会社ネクスティ エレクトロニクス

- 東京本社(本店)** 〒108-8510 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
TEL:03-5462-9611 FAX:03-5462-9690
- 名古屋本社** 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル
TEL:052-558-4100 FAX:052-561-1761
- 大阪支店** 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-3-11 大阪豊田ビル
TEL:06-6243-6611 FAX:06-6243-6701
- 仙台営業所** 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー
TEL:022-221-8061 FAX:022-221-8055
- 松本営業所** 〒390-0815 長野県松本市深志2-5-26 松本第一ビル
TEL:0263-34-6131 FAX:0263-34-6130
- 神戸営業所** 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル
TEL:078-272-1660 FAX:078-272-1770
- 福岡営業所** 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5 紙与博多ビル
TEL:092-436-4001 FAX:092-436-4002
- 商品センター** 〒207-0021 東京都東大和市立野4-495
TEL:042-846-0001 FAX:042-846-0101
- VAセンター** 〒207-0021 東京都東大和市立野4-495
TEL:042-846-0088 FAX:042-846-0099
- TAQSセンター** 〒446-0004 愛知県安城市尾崎町大縄1-3 豊通物流ビル
TEL:0566-96-4433 FAX:0566-97-3467

